

DA 90 固晶胶 产品技术数据表

高导热性能

优异的耐湿性能

高可靠性

简介

DA 90 是一种以银为填料的高导热、无溶剂、快速固化型热固性贴片导电胶。该产品对基板及裸芯片具有优异的粘接性能, 适用于小尺寸及大尺寸芯片贴装(Die Attach)应用。DA 90 可通过点胶或印刷工艺进行施胶, 在高温回流焊条件下表现出优异的可靠性和稳定性, 适合高可靠性电子封装应用。

物理特性

产品名称	DA 90 固晶胶
填料	银 (Silver)
未固化材料性能	
项目	数值
比重 ASTM D1475-60	3.0 – 3.5 g/cc
粘度 ASTM D-1384	10-25 kcP
固化后材料性能	
拉伸强度 (MPa)	56
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	25 ppm/°C
杨氏模量 (GPa)	2 – 3.5
导热系数 (W/mK)	2 – 5
体积电阻率 (Ω·cm)	0.00003 – 0.00008

芯片剪切强度(Kg/mm2)	2x2mm Silicon die on Pd: 2.0 2X2mm Au silicon die on bare Cu: 2.5 2x2mm Au silicon die on Au: 2.3
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过

应用工艺

在 90 – 120°C 条件下固化 50 – 90 分钟。

注:上述固化时间不包含胶层达到目标固化温度所需的升温时间。可根据具体工艺需求评估并采用其他固化曲线。

储存与保质期

在 -40°C 以下、密封原包装条件下储存, 保质期为 6 个月。超过保质期储存可能导致粘度升高。请避免材料暴露于湿气、挥发、污染物或异物中, 否则可能影响其工艺性能。

安全说明

DA 90 为环保型、无毒材料。但在操作和使用过程中, 仍建议遵循一般工业卫生与安全操作规范。有关更详细的安全与操作信息, 请参阅本产品的 安全数据表(SDS)。

包装规格

DA 90 导电胶提供10cc, 30cc 两种包装规格。其他包装规格可依客户需求提供。如需订购信息, 请联系YINCAE公司。